

证券代码：603061

证券简称：金海通

天津金海通半导体设备股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025-006

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场访谈 ☐ 其他 ☐ 线上分析师会议 ☒ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 线上调研
参与单位名称	参与业绩说明会的投资者。
时间	2025 年 11 月 6 日
地点	上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ）。
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理崔学峰先生、独立董事孙晓伟先生、副总经理兼董事会秘书刘海龙先生、财务总监黄洁女士。
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍主要内容 金海通的主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品在集成电路封测行业有较高的知名度和认可度，产品遍布中国大陆、中国台湾、东南亚、欧美等全球市场。 公司自成立以来，一直坚持深耕集成电路测试分选机的研发、生产和销售。公司深耕平移式测试分选机领域，产品根据可测试工位、测试环境等测试分选需求分为 EXCEED-6000 系列、EXCEED-8000 系列、EXCEED-9000 系列、SUMMIT 系列、COLLIE 系列、NEOCEED

系列等。

公司的核心技术集中于“高速运动姿态自适应控制技术”、“高兼容性上下料技术”、“高精度温控技术”、“芯片全周期流程监控技术”等领域。公司产品的软件定制化程度高，集成程度高，反馈速度快，技术支持响应度好；产品的 UPH（单位小时产出）、Jam rate（故障停机率）、可并行测试最大工位等指标已达到同类产品的国际先进水平。

二、公司 2025 年第三季度经营情况介绍

受公司所在的半导体封装和测试设备领域需求回暖等因素影响，公司 2025 年第三季度实现营业收入 1.74 亿元，较上年同期增长 137.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,897.57 万元，较上年同期增长 832.58%；公司 2025 年前三季度实现营业收入 4.82 亿元，较上年同期增长 87.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.25 亿元，较上年同期增长 178.18%。截至 2025 年 9 月末，公司总资产为 19.56 亿元，较上年末增长 22.38%；截至 2025 年 9 月末，公司净资产为 15.39 亿元，较上年末增长 16.94%。

产品方面，2025 年第三季度，公司持续跟进集成电路测试分选行业细分领域头部客户的前瞻性的测试分选需求，持续对现有产品在温度控制、并测工位、可测试芯片尺寸、上下料方式和压力控制等方面进行技术研发和产品迭代。

公司适用于 MEMS 的测试分选平台、适用于碳化硅及 IGBT 的测试分选平台以及专用于先进封装产品的测试分选平台已经在多个客户现场进行产品验证。同时，对于适用于 Memory 的测试分选平台，公司在既有技术储备的基础上持续关注细分市场不断变化的测试分选需求。

公司持续加大研发投入，募投项目“半导体测试设备智能制造及创新研发中心一期项目”按照既定计划有序推进，建成后将进一步增加公司研发及制造等综合竞争力。

市场推广方面，公司持续加大市场推广力度，不断精进全球化市场服务能力，深化客户服务。2025 年前三季度，公司积极拓展新客户，持续深化既有客户合作关系，全面强化客户服务能力建设，公司“马

来西亚生产运营中心”的启用助力公司更好地贴近全球市场和客户、响应客户需求。

三、业绩说明会问答

1、问：你好，贵司有 HBM 芯片制造工艺相关的设备吗？

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售。公司产品集成电路测试分选机主要适用于 QFN（四边扁平无引脚封装）、QFP（方型扁平式封装）、BGA（球栅阵列封装）、LGA（栅格阵列封装）、PLCC（塑料有引线片式载体封装）、PGA（插针网格阵列封装）、CSP（芯片级尺寸封装）、TSOP（薄型小尺寸封装）等封装形式的芯片。公司客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司产品集成电路测试分选机在客户公司所分选的芯片涵盖汽车电子、消费电子、智能互联、5G 等领域中应用的芯片。公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为。敬请投资者谨慎注意投资风险。

2、问：请问贵公司的核心产品与 3d 封装有关系不？

答：3D 封装是指半导体芯片封装过程中使用的一种先进封装工艺技术，在多种半导体产品的封装过程中都可应用。公司产品测试分选机，是在半导体产品设计验证环节和成品检测环节，配合测试机对芯片封装后的成品进行测试分选。据公司了解，使用 2.5D、3D 封装技术的芯片，其成品多表现为 BGA（球栅阵列封装）、LGA（栅格阵列封装）、PGA（插针网格阵列封装）等封装形式，可以使用公司的设备进行成品测试分选。公司产品应用于某类芯片测试分选的具体情况系客户公司经营行为。

3、问：恭喜公司重新进入发展的快车道，个人认为公司美中不足的一点是产品种类较为单一，是否可以借着资本市场红利尽快展开收购扩展公司品类为未来的扎实扩张奠定坚实的基础，谢谢。

答：公司主营业务为集成电路测试分选机的研发、生产及销售，集成电路测试分选机主要应用于集成电路设计阶段中的验证环节和封装测试阶段的成品测试环节，客户群体涵盖半导体封装测试企业、测试代工厂、IDM 企业（半导体设计制造一体化厂商）、芯片设计公司等。公司自成立以来深耕集成电路测试分选机领域，经过多年的研发和创新，公司产品的主要技术指标及功能达到同类产品国际先进水

	平。公司将结合中长期战略发展规划，持续评估收购或并购等事项，若后续有相关事项，公司将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。
附件清单 (如有)	无
风险提示	以上如涉及公司所处行业发展趋势、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业发展、公司发展或业绩的预测和承诺，不构成公司或公司管理层对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
日期	2025 年 11 月 10 日